

证券代码： 300632

证券简称：光莆股份

厦门光莆电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20260515

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2026年5月15日(周五)下午14:30~17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、董事长林国彪 2、副总经理吴晞敏 3、独立董事戴建宏 4、财务总监管小波 5、董事会秘书张金燕
投资者关系活动主要内容介绍	投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、2026年公司有什么的规划，林总的三年计划有可能计划性落实？ 尊敬的投资者，您好！2026年，公司将继续战略聚焦光电集成封测及光电智能传感器领域，探索2.5D/3D封装技术在光电集成共封技术的应用延伸，从光传感互用至光通信的光引擎、光应用等领域，为光电复合器件高端国产化替代提供持续技术支撑；把AI植入光电集成传感器，打造“感算一体”的高精准光电集成传感器、TOF模组等核心器件，为机器人、无人机、人工智能等企业提供核心智能硬件；紧扣技术引领、全球深耕、生态共建等主线，巩固半导体光电集成传感领域的技术领先地位，加速跨国经营体系成熟，推动光电集成传感业务规模化、高端化发展；依托

资本联动布局，致力成长为半导体光电集成封测及智能传感器赛道的全球标杆企业。公司的战略规划和经营计划，不构成对未来业绩的承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

2、您好，赛勒光电目前还是亏损状态，合资业务也在爬坡。请问：最大的风险是良率、客户认证、还是价格战？公司有没有做风险对冲和备选方案？

尊敬的投资者，您好！公司投资该企业是综合考虑其技术能力、产品路线、客户资源、量产基础和与公司业务、战略协同的可能性等因素而做出的审慎决定，通过本次投资，将有助于加速推进“光电集成共封技术从光传感互用延伸至光通信的光引擎”的战略布局落地。公司与赛勒光电的相关合作仍处于推进阶段，合作协议执行进度、合资公司设立及业务开展存在不确定性，公司将根据后续进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

3、车载光通信、星间光通信、AI 数据中心光模块都是大赛道。目前合资公司已经进入哪些车企/云厂商/设备商供应链？和中际旭创、光迅科技、新易盛比，你们的差异化优势是什么？

尊敬的投资者，您好！一方面，公司深耕光电集成先进封装与光传感领域多年，已掌握成熟的高端光电集成先进封装工艺，具备向光通信的光引擎、光应用等领域拓展研发的技术储备。另一方面，公司推进与赛勒光电的增资及合资合作，双方将形成技术互补与产业链上下游的协同，共同打造 PIC+光引擎产品的全链条解决方案，打通从硅光子芯片封测到光引擎的完整技术体系和交付能力。目前双方合作仍处于推进阶段，合作协议执行进度、合资公司设立及业务开展存在不确定性，公司将根据后续进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

4、上游光芯片、核心材料外购依赖度高，会不会被卡脖子？自研替代进度、长协保供方案？

尊敬的投资者，您好！公司推进与赛勒光电的增资及合资合作，双方将形成技术互补与产业链上下游的协同，共同打造 PIC+

光引擎产品的全链条解决方案，打通从硅光子芯片封测到光引擎的完整技术体系和交付能力。目前双方合作仍处于推进阶段，合作协议执行进度、合资公司设立及业务开展存在不确定性，公司将根据后续进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

5、公司战略重心：LED 收缩、全力聚焦 CPO 光集成 智能传感 复合铜箔，未来 3 年业务取舍优先级？

尊敬的投资者，您好！2026 年，公司将继续战略聚焦光电集成封测及光电智能传感器领域，探索 2.5D/3D 封装技术在光电集成共封技术的应用延伸，从光传感互用至光通信的光引擎、光应用等领域，为光电复合器件高端国产化替代提供持续技术支撑；把 AI 植入光电集成传感器，打造“感算一体”的高精准光电集成传感器、TOF 模组等核心器件，为机器人、无人机、人工智能等企业提供核心智能硬件；紧扣技术引领、全球深耕、生态共建等主线，巩固半导体光电集成传感领域的技术领先地位，加速跨国经营体系成熟，推动光电集成传感业务规模化、高端化发展；依托资本联动布局，致力成长为半导体光电集成封测及智能传感器赛道的全球标杆企业。公司的战略规划和经营计划，不构成对未来业绩的承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

6、董事长您好，公司对赛勒光电增资 5000 万、持股 5.4%，又合资控股 75%成立新公司，这个“参股控股”的双绑定战略，核心目的是什么？未来会不会进一步增持赛勒光电、甚至并购？

尊敬的投资者，您好！公司投资该企业是综合考虑其技术能力、产品路线、客户资源、量产基础和与公司业务、战略协同的可能性等因素而做出的审慎决定，通过本次投资，将有助于加速推进“光电集成共封技术从光传感互用延伸至光通信的光引擎”的战略布局落地。公司与赛勒光电的相关合作仍处于推进阶段，合作协议执行进度、合资公司设立及业务开展存在不确定性，公司将根据后续进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

7、行业价格战加剧，公司长期议价权、客户粘性、独家供货壁垒如何巩固？如何避免毛利持续下滑？

尊敬的投资者，您好！公司将继续聚焦光电集成封测及光电智能传感器领域，通过持续地研发创新和产品迭代，提升公司产品的市场竞争力；并将拓展新的产品品类，创新应用场景，不断优化产品结构和产业结构，增加产品附加值；同时，通过资本联动布局产业链优质资源，实现技术协同、产能协同、市场协同与资本协同，提升产业链整合能力与核心竞争力。公司的战略规划和经营计划，不构成对未来业绩的承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

8、目前整体毛利率承压，全年毛利率修复目标和改善措施是什么？

尊敬的投资者，您好！公司将通过加快产能爬坡、提高稼动率、优化产销结构、严控成本费用、强化海内外基地协同运营等措施，尽快实现规模效益，扭转阶段性投入产出失衡状况。感谢您的关注！

9、协议里写了赛勒光电 PIC 芯片 20%以上要优先供给光莆，合作知识产权排他。请问这个排他期限多久？会不会出现赛勒以后把技术/芯片再卖给别家的情况？

尊敬的投资者，您好！上述约定是双方在合作协议中约定的双方在产业协同、供应保障和联合开发方面的合作机制。公司将在合作推进过程中，重点关注产品开发进度、客户验证结果、供应链稳定性、量产交付能力和商业化可持续性。公司与赛勒光电的相关合作仍处于推进阶段，合作协议执行进度、合资公司设立及业务开展存在不确定性，公司将根据后续进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

10、塞勒新品送样的情况怎么样？高于还是低于预期？开始准备量产了吗？

尊敬的投资者，您好！出于合作方商业保密要求，公司不便披露，若后续有达到信息披露标准的，公司将及时履行信息披露

义务。感谢您的关注！

11、管理层您好。面对目前行业内较为激烈的市场竞争态势，公司在今年的市场开拓（例如渠道下沉、新客户拓展或海外市场布局）上，主要有哪些侧重点或新的规划思路？

尊敬的投资者，您好！公司将继续战略聚焦光电集成封测及光电智能传感器领域，探索 2.5D/3D 封装技术在光电集成共封技术的应用延伸，从光传感互用至光通信的光引擎、光应用等领域，为光电复合器件高端国产化替代提供持续技术支撑；把 AI 植入光电集成传感器，打造“感算一体”的高精准光电集成传感器、TOF 模组等核心器件，为机器人、无人机、人工智能等企业提供核心智能硬件；紧扣技术引领、全球深耕、生态共建等主线，巩固半导体光电集成传感领域的技术领先地位，加速跨国经营体系成熟，推动光电集成传感业务规模化、高端化发展；依托资本联动布局，致力成长为半导体光电集成封测及智能传感器赛道的全球标杆企业。公司的战略规划和经营计划，不构成对未来业绩的承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

12、总经理你好，本人公司小散户，非常看好光蒲自身优势与赛勒的先进研发产品，请问合资公司的注册时间预计在什么时候！然后对于合资公司的产品公司是否具备相对应的技术储备完成产品的生产及交付！如何看待公司微型 CPO 技术在未来的应用场景！谢谢

尊敬的投资者，您好！公司与赛勒光电的合作仍处于推进阶段，合作协议执行进度、合资公司设立及业务开展存在不确定性，目前该业务对公司业绩影响较小，存在不确定性。公司将根据后续进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

13、传统 LED 业务是否会收缩出清，什么时候彻底止损不再拖累利润？

尊敬的投资者，您好！2026 年，公司将继续战略聚焦光电集成封测及光电智能传感器领域，探索 2.5D/3D 封装技术在光电集成共封技术的应用延伸，从光传感互用至光通信的光引擎、光应

用等领域，为光电复合器件高端国产化替代提供持续技术支撑；把 AI 植入光电集成传感器，打造“感算一体”的高精准光电集成传感器、TOF 模组等核心器件，为机器人、无人机、人工智能等企业提供核心智能硬件；紧扣技术引领、全球深耕、生态共建等主线，巩固半导体光电集成传感领域的技术领先地位，加速跨国经营体系成熟，推动光电集成传感业务规模化、高端化发展；依托资本联动布局，致力成长为半导体光电集成封测及智能传感器赛道的全球标杆企业。公司的战略规划和经营计划，不构成对未来业绩的承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

14、想请问公司，目前微型 CPO 和光引擎，已经切入业内哪些知名大厂供应链了？现在是送样认证、小批量，还是已经量产供货？

尊敬的投资者，您好！公司推进“光电集成共封技术从光传感互用延伸至光通信的光引擎”的战略布局落地，相关技术及业务处于推进阶段，未来业务的开展仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

15、2026 全年营收拆分：传统 LED、光传感、微型 CPO、复合铜箔、车载/机器人各板块目标营收占比？

尊敬的投资者，您好！2026 年，公司将继续战略聚焦光电集成封测及光电智能传感器领域，探索 2.5D/3D 封装技术在光电集成共封技术的应用延伸，从光传感互用至光通信的光引擎、光应用等领域，为光电复合器件高端国产化替代提供持续技术支撑；把 AI 植入光电集成传感器，打造“感算一体”的高精准光电集成传感器、TOF 模组等核心器件，为机器人、无人机、人工智能等企业提供核心智能硬件；紧扣技术引领、全球深耕、生态共建等主线，巩固半导体光电集成传感领域的技术领先地位，加速跨国经营体系成熟，推动光电集成传感业务规模化、高端化发展；依托资本联动布局，致力成长为半导体光电集成封测及智能传感器赛道的全球标杆企业。公司的战略规划和经营计划，不构成对未来业绩的承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

16、请问公司微型 CPO、光引擎业务，目前已进入哪些行业头部大

厂的供应链？是送样、认证、小批量还是正式量产供货？

尊敬的投资者，您好！公司推进“光电集成共封技术从光传感互用延伸至光通信的光引擎”的战略布局落地，相关技术及业务处于推进阶段，未来业务的开展仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

17、未来 2 - 3 年，公司在 CPO、车载、复合铜箔三大主业上，客户拓展的优先级和目标知名客户布局是什么？

尊敬的投资者，您好！2026 年，公司将继续战略聚焦光电集成封测及光电智能传感器领域，探索 2.5D/3D 封装技术在光电集成共封技术的应用延伸，从光传感互用至光通信的光引擎、光应用等领域，为光电复合器件高端国产化替代提供持续技术支撑；把 AI 植入光电集成传感器，打造“感算一体”的高精准光电集成传感器、TOF 模组等核心器件，为机器人、无人机、人工智能等企业提供核心智能硬件；紧扣技术引领、全球深耕、生态共建等主线，巩固半导体光电集成传感领域的技术领先地位，加速跨国经营体系成熟，推动光电集成传感业务规模化、高端化发展；依托资本联动布局，致力成长为半导体光电集成封测及智能传感器赛道的全球标杆企业。公司的战略规划和经营计划，不构成对未来业绩的承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

18、翔安 CPO 新产能今年、明年产能规模、良率爬坡、满产时间怎么安排？

尊敬的投资者，您好！公司推进“光电集成共封技术从光传感互用延伸至光通信的光引擎”的战略布局落地，相关技术及业务处于推进阶段，未来业务的开展仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

19、AI 边缘算力、人形机器人、智能驾驶、低空经济，哪条赛道是第一增长曲线？爆发顺序？

尊敬的投资者，您好！2026 年，公司将继续战略聚焦光电集成封测及光电智能传感器领域，探索 2.5D/3D 封装技术在光电集成共封技术的应用延伸，从光传感互用至光通信的光引擎、光应

用等领域，为光电复合器件高端国产化替代提供持续技术支撑；把 AI 植入光电集成传感器，打造“感算一体”的高精准光电集成传感器、TOF 模组等核心器件，为机器人、无人机、人工智能等企业提供核心智能硬件；紧扣技术引领、全球深耕、生态共建等主线，巩固半导体光电集成传感领域的技术领先地位，加速跨国经营体系成熟，推动光电集成传感业务规模化、高端化发展；依托资本联动布局，致力成长为半导体光电集成封测及智能传感器赛道的全球标杆企业。公司的战略规划和经营计划，不构成对未来业绩的承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

20、厦门翔安 CPO 光引擎：2026/2027/2028 月度产能、良率、满产利用率明确数据？

尊敬的投资者，您好！公司推进“光电集成共封技术从光传感互用延伸至光通信的光引擎”的战略布局落地，相关技术及业务处于推进阶段，未来业务的开展仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

21、董事长，您好，请问：

(1) 公司与赛勒光电的合作，在光模块业务方面，可以发挥各自的哪些优势？

(2) 设立合资公司的公告里提到：针对光引擎业务，由赛勒光电提供 PIC 芯片，合资公司进行光引擎产品的研发及销售，光引擎的光电共封委托给光莆股份完成。请问公司储备的哪些技术适用于光电共封？

(3) 公司现有的生产基地，经调改后，能否用来生产光模块产品？

(4) 公司对于 CPO 业务有哪些规划？

尊敬的投资者，您好！一方面，公司深耕光电集成先进封装与光传感领域多年，已掌握成熟的高端光电集成先进封装工艺，具备向光通信的光引擎、光应用等领域拓展研发的技术储备。另一方面，公司推进与赛勒光电的增资及合资合作，双方将形成技术互补与产业链上下游的协同，共同打造 PIC+光引擎产品的全链条解决方案，打通从硅光子芯片封测到光引擎的完整技术体系和

交付能力。公司已有的部分生产设备可与光通信的光引擎生产互用。目前公司与赛勒光电的合作仍处于推进阶段，合作协议执行进度、合资公司设立及业务开展存在不确定性，公司将根据后续进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

22、公司今年什么时候能实现整体业绩稳定扭亏，明确拐点时间？

尊敬的投资者，您好！2026年，公司将继续通过提升产能利用率、优化产品结构、强化费用管理和推进新业务落地，努力改善盈利质量。感谢您的关注！

23、光莆擅长封测、赛勒擅长硅光设计，合资是“设计—封测—光引擎”闭环。目前这个闭环打通到哪一步？有没有已经送样/认证的头部客户（如华为、比亚迪、英伟达、微软）？

尊敬的投资者，您好！公司与赛勒光电的合作仍处于推进阶段，合作协议执行进度、合资公司设立及业务开展存在不确定性，公司将根据后续进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

24、合资公司主打光引擎、车载光模块、星间光通信、OCS/OIO，还有海外 PIC 封测。目前哪一块最先量产、最先贡献收入？800G/1.6T 硅光芯片良率现在多少？3.2T 什么时候工程化/量产？

尊敬的投资者，您好！出于合作方商业保密要求，公司不便披露。公司与赛勒光电的合作仍处于推进阶段，合作协议执行进度、合资公司设立及业务开展存在不确定性，公司将根据后续进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

25、在微型 CPO、光电封装上，相比同行核心护城河和差异化优势是什么

尊敬的投资者，您好！公司推进“光电集成共封技术从光传感互用延伸至光通信的光引擎”的战略布局落地，相关技术及业务处于推进阶段，未来业务的开展仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

26、传统 LED 业务持续拖累利润，LED 何时收缩/止损/剥离？高毛利 CPO/传感器多久能覆盖盈亏缺口？

尊敬的投资者，您好！LED 相关业务持续为公司贡献利润。2026 年，公司将继续通过提升产能利用率、优化产品结构、强化费用管理和推进新业务落地，努力改善盈利质量。感谢您的关注！

27、公司微型 CPO 目前在手订单、客户认证、量产交付进度如何？

尊敬的投资者，您好！公司推进“光电集成共封技术从光传感互用延伸至光通信的光引擎”的战略布局落地，相关技术及业务处于推进阶段，未来业务的开展仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

28、2025 全年亏损、2026 一季报扣非依旧亏损，预计何时实现全年稳定扭亏？各季度盈亏拐点明确时间？

尊敬的投资者，您好！2026 年，公司将继续通过提升产能利用率、优化产品结构、强化费用管理和推进新业务落地，努力改善盈利质量。感谢您的关注！

29、2025 年公司亏损 1274 万，2026Q1 利润也大幅下滑。市场都指望赛勒合资业务扭亏。请问：这块业务什么时候开始盈利？2026 全年对归母净利润的贡献预期是多少？毛利率能做到多少？

尊敬的投资者，您好！公司与赛勒光电的合作仍处于推进阶段，合作协议执行进度、合资公司设立及业务开展存在不确定性，目前该业务对公司业绩影响较小，存在不确定性。公司将根据后续进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

30、微型 3mm CPO 光引擎全球紧缺，在手长单、意向订单金额、交付周期、头部客户认证进度？

尊敬的投资者，您好！公司坚定信心推进“光电集成共封技术从光传感互用延伸至光通信的光引擎”的战略布局落地，相关技术及业务处于逐步开展和推进阶段，未来业务的开展仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

31、您好，公司的五河县项目，马来西亚的，以及厦门的项目，都什么时候产生营收，

尊敬的投资者，您好！厦门“光电传感器件集成封测研发及产业化项目”和“海外智能制造基地(马来西亚二厂)扩建项目”

均已在 2025 年顺利建成。感谢您的关注！

32、3mm 微型 CPO 全球稀缺量产，技术壁垒、专利壁垒、封装 Know-how 护城河能维持多久？同行多久能追赶？

尊敬的投资者，您好！公司坚定信心推进“光电集成共封技术从光传感互用延伸至光通信的光引擎”的战略布局落地，相关技术及业务处于逐步开展和推进阶段，未来业务的开展仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

33、复合铜箔项目投产节奏、头部客户定点及批量供货时间表？

尊敬的投资者，您好！目前相关业务暂未绑定头部客户，且在公司整体业绩中的占比相对较小，敬请广大投资者注意投资风险。

34、复合铜箔业务 2026-2027 产能放量，绑定宁德/比亚迪等头部客户定点、批量供货节奏？

尊敬的投资者，您好！目前相关业务暂未绑定头部客户，且在公司整体业绩中的占比相对较小，敬请广大投资者注意投资风险。

35、复合铜箔目前对接的头部动力电池企业有哪些？处于送样测试、中试、小批量还是批量供货哪个阶段？

尊敬的投资者，您好！目前相关业务暂未绑定头部客户，且在公司整体业绩中的占比相对较小，敬请广大投资者注意投资风险。

36、有没有和头部电池企业达成长期合作意向或者框架协议？后续产能和客户供货是怎么匹配规划的？

尊敬的投资者，您好！公司暂未和头部电池企业达成长期合作意向或框架协议，敬请广大投资者注意投资风险。

37、是否和一线电池厂商达成长期合作意向或框架协议？后续客户导入和产能匹配供货节奏如何安排？

尊敬的投资者，您好！公司暂未和一线电池厂商达成长期合作意向或框架协议，敬请广大投资者注意投资风险。

38、公司最大的核心优势是什么？

尊敬的投资者，您好！公司的核心竞争优势已在公司 2025 年年度报告中详细披露，敬请查阅公司于 2026 年 4 月 24 日发布的《2025 年年度报告》。感谢您的关注！

39、接下来一到两年，CPO 这块准备重点拓展哪些一线客户，导入节奏大概是怎么安排的？

尊敬的投资者，您好！公司坚定信心推进“光电集成共封技术从光传感互用延伸至光通信的光引擎”的战略布局落地，相关技术及业务处于逐步开展和推进阶段，未来业务的开展仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

40、公司大额扩产资本开支大，资金来源和财务风险怎么管控？

尊敬的投资者，您好！公司目前资本开支主要是自有资金及募投资金，公司会严格管控财务风险。感谢您的关注！

41、海外马来西亚一二三期扩产，产能匹配订单情况，是否存在闲置产能风险？

尊敬的投资者，您好！公司根据客户需求和订单进行产能扩建，2025 年，公司马来西亚一厂产能饱满，海外智能制造基地(马来西亚二厂)已按计划建成，目前在产能爬坡中，暂无闲置风险。感谢您的关注！

42、产能优先倾斜高毛利 CPO，机器人、车载、AR 赛道长期无产能分配，会不会错失行业红利？

尊敬的投资者，您好！在光电集成封测业务领域，公司主要作为核心零部件的上游供应商，为芯片、模组厂家提供光电传感集成封测产品，公司已与行业内多家头部传感器芯片厂/模组厂建立了稳定的合作关系。同时，通过投资和合资，推进“光电集成共封技术从光传感互用延伸至光通信的光引擎”的战略布局落地，相关技术及业务处于逐步开展和推进阶段，未来业务的开展仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

43、和国内头部光模块大厂、AI 服务器厂商是直接合作还是间接供货？有没有定点入围、长期框架协议？

尊敬的投资者，您好！公司坚定信心推进“光电集成共封技

术从光传感互用延伸至光通信的光引擎”的战略布局落地，相关技术及业务处于逐步开展和推进阶段，未来业务的开展仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

44、全链条自研 30 年光电封装经验，对比中际旭创、新易盛等光模块企业，差异化不可替代优势是什么？

尊敬的投资者，您好！一方面，公司深耕光电集成先进封装与光传感领域多年，已掌握成熟的高端光电集成先进封装工艺，具备向光通信的光引擎、光应用等领域拓展研发的技术储备。另一方面，公司推进与赛勒光电的增资及合资合作，双方将形成技术互补与产业链上下游的协同，共同打造 PIC+光引擎产品的全链条解决方案，打通从硅光子芯片封测到光引擎的完整技术体系和交付能力。目前双方合作仍处于推进阶段，合作协议执行进度、合资公司设立及业务开展存在不确定性，公司将根据后续进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

45、2.5D/3D 叠 Die 先进封装、微型 CPO，从技术领先转向规模化市场领先，具体落地路径？

尊敬的投资者，您好！公司将继续战略聚焦光电集成封测及光电智能传感器领域，探索 2.5D/3D 封装技术在光电集成共封技术的应用延伸，从光传感互用至光通信的光引擎、光应用等领域，为光电复合器件高端国产化替代提供持续技术支撑；把 AI 植入光电集成传感器，打造“感算一体”的高精准光电集成传感器、TOF 模组等核心器件，为机器人、无人机、人工智能等企业提供核心智能硬件；紧扣技术引领、全球深耕、生态共建等主线，巩固半导体光电集成传感领域的技术领先地位，加速跨国经营体系成熟，推动光电集成传感业务规模化、高端化发展；依托资本联动布局，致力成长为半导体光电集成封测及智能传感器赛道的全球标杆企业。公司的战略规划和经营计划，不构成对未来业绩的承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

46、公司车载电子、HUD、车载传感等产品，目前合作的主流整车厂有哪些？哪些已经实现定点量产、稳定供货？

尊敬的投资者，您好！在光电集成封测业务领域，公司主要作为核心零部件的上游供应商，为芯片、模组厂家提供光电传感集成封测产品。公司已与行业内多家头部传感器芯片厂/模组厂建立了稳定的合作关系，应用在智能驾驶领域的器件已实现销售。敬请广大投资者注意投资风险。

47、在 AI 算力、高速光互联领域，公司客户是否涵盖一线生态厂商？后续客户拓展和导入节奏怎么规划？

尊敬的投资者，您好！公司坚定信心推进“光电集成共封技术从光传感互用延伸至光通信的光引擎”的战略布局落地，相关技术及业务处于逐步开展和推进阶段，未来业务的开展仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

48、认证进度？车载 HUD、人形机器人、AR/VR 赛道目前有无批量营收？送样转量产节点？

尊敬的投资者，您好！公司光电集成封测产品在机器人、智能驾驶等应用场景实现客户突破与应用，目前相关业务在公司整体业绩中的占比相对较小，公司将密切关注行业发展机遇、积极布局，同时敬请广大投资者注意投资风险。

49、智能传感、光电组件有没有进入人形机器人、ARVR、消费电子头部品牌的供应链？合作进展到哪一步了？

尊敬的投资者，您好！在光电集成封测业务领域，公司主要作为核心零部件的上游供应商，为芯片、模组厂家提供光电传感集成封测产品。公司已与行业内多家头部传感器芯片厂/模组厂建立了稳定的合作关系，应用在机器人、消费电子、智能驾驶等领域的器件已实现销售。感谢您的关注！

50、全球化布局（香港 马来西亚），海外市场拓展、海外大客户、海外营收长期目标？

尊敬的投资者，您好！公司将强化香港、东南亚、北美运营公司等海外运营平台和产业化基地的核心功能与承载能力，构建“中国+东南亚+北美”研发及生产智造的新“全球化+本地化”产业格局；推动海外智能制造基地产能稳步释放，布局马来西亚

	<p>工厂光电集成共封先进制造产线，实现传感器模组、智能控制硬件、光电集成共封等产品的规模化的海外交付能力，提升全球生产与交付布局；以“国际化数智协同+本地化深耕”的双循环模式，在全球关键区域布局卫星工厂，持续构建高效协同的供应链枢纽，打造可持续的全球竞争力。公司的战略规划和经营计划，不构成对未来业绩的承诺，敬请广大投资者注意投资风险。</p> <p>51、公司光传感、光电组件有没有切入人形机器人、AR/VR、消费电子头部厂商供应链？合作进展到哪一步？</p> <p>尊敬的投资者，您好！在光电集成封测业务领域，公司主要作为核心零部件的上游供应商，为芯片、模组厂家提供光电传感集成封测产品。公司已与行业内多家头部传感器芯片厂/模组厂建立了稳定的合作关系，应用在机器人、消费电子、智能驾驶等领域的器件已实现销售。感谢您的关注！</p> <p>52、未来三年营收结构怎么规划，CPO、传感、车载、复合铜箔各自营收占比目标？</p> <p>尊敬的投资者，您好！2026年，公司将继续战略聚焦光电集成封测及光电智能传感器领域，探索2.5D/3D封装技术在光电集成共封技术的应用延伸，从光传感互用至光通信的光引擎、光应用等领域，为光电复合器件高端国产化替代提供持续技术支撑；把AI植入光电集成传感器，打造“感算一体”的高精准光电集成传感器、TOF模组等核心器件，为机器人、无人机、人工智能等企业提供核心智能硬件；紧扣技术引领、全球深耕、生态共建等主线，巩固半导体光电集成传感领域的技术领先地位，加速跨国经营体系成熟，推动光电集成传感业务规模化、高端化发展；依托资本联动布局，致力成长为半导体光电集成封测及智能传感器赛道的全球标杆企业。公司的战略规划和经营计划，不构成对未来业绩的承诺，敬请广大投资者注意投资风险。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2026-05-15